

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2023-008

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2022年年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、经苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 20,000 万元至 24,000 万元，同比下降 58.34% 至 65.28%。

2、扣除非经常性损益事项后，预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 18,000 万元至 22,000 万元，同比下降 53.32% 至 61.81%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 20,000 万元至 24,000 万元，同比下降 58.34% 至 65.28%。

2、扣除非经常性损益事项后，预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 18,000 万元至 22,000 万元，同比下降 53.32% 至 61.81%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：57,604.51 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：47,129.40 万元。

(二) 每股收益：1.41 元。

三、本期业绩预减的主要原因

1、在国际贸易形式、地缘政治冲突、新冠肺炎疫情等诸多不利因素影响下，全球经济增速持续面临下行风险，以手机为代表的消费类电子市场需求不足，对公司整体封装业务带来不利影响。虽然公司在车载摄像头、微型光学器件等新领域顺利实现规模量产，但整体规模还有待持续提升，上述原因使得报告期内公司整体营收与利润较去年下降。

2、报告期内公司持续加大对创新技术工艺的布局和研发投入，其中围绕车规半导体市场需求，针对车载摄像头封装、MEMS封装、微型光学器件、功率器件等方向加大了研发投入力度。

3、基于宏观经济环境与行业需求下行趋势，报告期内公司对库存、闲置固定资产等进行了相应的减值计提与处置。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2023年1月31日